



双安资管、北京遵道资管、广东富业盛德资管、浙江米仓资管、上海理成资管、华泰证券(上海)资管、山证国际资管、百年保险资管、光大永明资管、龙航资管、盛世景资管、泰康资管、大家资管、新华资管、上海钦沐资管、华安财保资管、山高国际资管、上海睿郡资管、东方证券资管、浙商证券资管、东证融汇证券资管、天风证券资管、中泰证券资管、光大证券资管、广发证券资管、招商证券资管、财通证券资管、上海复甯投资、上海同犇投资、上海阿杏投资、上海紫阁投资、汇丰环球投资、五矿鑫扬投资、上海聆泽投资、上海泾溪投资、深圳市远望角投资、深圳鑫然投资、上海标朴投资、深圳清水源投资、杭州凯岩投资、上海正心谷投资、上海弥远投资、北京市星石投资、北京致顺投资、杭州乐信投资、江苏瑞华投资、上海通怡投资、湖南万泰华瑞投资、中融鼎(深圳)投资、浙江旌安投资、上海锐天投资、西藏源乘投资、上海明河投资、上海重阳投资、杭州萧山泽泉投资、浙江秘银投资、上海煜德投资、上海长见投资、前海矩阵投资、深圳丞毅投资、友邦投资、杭州凯昇投资、上海天猊投资、上海海宸投资、弘则弥道(上海)投资、上海泽娴投资、上海乾惕投资、明水投资、淡水泉(北京)投资、深圳鼎信金融投资、天泉投资、华美国际投资、中银三星人寿、亚太财险、中国平安保险、国投泰康信托、苏州信托、英大国际信托、长江期货、汇华理财、兴银理财、建信金融、苏银理财、宁银理财、杭银理财、广西赢舟管理咨询、中国对外经济贸易信托、上海探颐、盈米投顾、三星资产(香港)、上海复星、海雅金融、深圳创富兆业、深圳达晨财智创投、LIBRARY GROUP、Torq Capital Management、Willing Capital、UBS、CPPIB AE、UG INVESTMENT、Marco Polo Fund、西部证券、中信证券、中金公司、中信建投证券、招商证券、天风证券、中银国际证券、财通证券、民生证券、汇丰前海证券、海通证券、开源证券、安信证券、国联证券、东吴证券、信达证券、国海证券、国信证券、长城证券、平安证券、太平洋证券、华创证券、方正证券、国金证券、国泰君安证券、西南证券、长江证券、兴业证券、东方财富证券、上海申银万国证券、华金证券、华福证券、浙商证券、中邮证券、中国银河证券、广发证券、华泰证券、东北证券、首创证券、光大证券、东方证券、中原证券、山西证券、华兴证券、国融证券、德邦证券、红塔证券、粤开证券、万和证券、中泰证券、申万宏源证券、东兴证券、野村东方国际证券、东吴证

	券（香港）、个人投资者
时间	2023年8月22日10:00
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司2023年半年度经营情况介绍</b></p> <p>从行业供需格局看，预期中的复苏并未如期到来。根据 PrismaMark 报告，全球线路板行业 Q1、Q2 分别同比下滑 20.3%、15.5%，预期 Q3 同比降幅缩窄至 5.9%，Q4 恢复正增长、同比增速 5.6%，全年行业规模为 741 亿美元、同比下滑 9.3%。从行业层面看，需求低迷，竞争加剧，但逐季环比回暖。</p> <p>公司整体经营表现一般：营收 25.66 亿元、同比下降 4.81%、好于行业平均水平，归母扣非净利润 634.76 万元、同比下降 97.66%，与 22 年同期相比归母扣非净利润减少了 2.65 亿元，主要原因与一季报类似：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、FCBGA 封装基板项目上半年费用投入 1.46 亿元、亏损 1.09 亿元；</li> <li>2、CSP 封装基板项目 2023 年上半年毛利亏损 2,222 万元，2022 年同期毛利为 10,174 万元，同比减少约 1.24 亿元；</li> <li>3、员工持股计划费用摊销 1,530 万元；</li> <li>4、因整体需求不足、竞争加剧，宜兴硅谷、美国 Harbor 均亏损，合计亏损约 3,549 万元，同比减少约 7,600 万元。</li> </ol> <p>传统 PCB 业务因整体供给过剩导致竞争加剧，从下游需求看仅汽车、医疗、航空航天、工控等领域保持小幅正增长，消费电子、通信等行业均呈现不同程度的下滑。</p> <p><b>二、公司半导体业务情况介绍及行业展望</b></p> <p>根据 PrismaMark 报告，半导体产业链经历严峻的去库存周期，EMS 厂商上半年整体下滑 6.4%，芯片产业下滑 26.6%，其中存储芯片行业量价齐跌、整体下滑 55.6%，晶圆代工厂下滑 10.5%，封装产业下滑 20.8%，整个产业链均遭受沉重的打击。受此影响，公司的半导体业务实现收入 46,991.81 万元、同比下降 22.02%，毛利率 0.19%。</p> <p>CSP 封装基板业务受下游需求影响导致整体稼动率不足，实现收入 28,941.13 万元、同比下降 22.75%，毛利率-7.68%。但从季度表现看，呈</p>

现需求逐步回暖的趋势,产能利用率从 Q1 的 30%左右提升至 Q2 接近 60%,目前订单情况较 Q2 进一步好转,下半年有望实现盈利。我们判断行业目前处于底部区域,随着全球经济的逐步企稳复苏,未来需求有望进一步回暖。

半导体测试板业务实现营业收入 18,050.67 万元、同比下降 20.84%,毛利率 12.81%。子公司 Harbor 亏损主要因为需求不足,广州基地的半导体测试板业务产能逐步释放,产品良率、交期、技术能力等稳定提升、持续改善。

根据 Prismark 报告,2022 至 2027 年封装基板的复合增速为 5.1%,有望实现优于行业平均的增长。我们对封装基板业务的长期发展持乐观态度,未来公司的主要资本开支和产能扩张也集中于封装基板业务。

### 三、FCBGA 封装基板项目的进展情况

珠海 FCBGA 封装基板项目拟建设产能 200 万颗/月(约 6,000 平方米/月)的产线,已于 2022 年 12 月底建成并成功试产。目前处于客户认证阶段,部分大客户的技术评级、体系认证均已通过,等待产品认证结束之后进入小批量生产阶段。

广州 FCBGA 封装基板项目拟分期建设 2000 万颗/月(2 万平方米/月)的产线,一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶,目前处于设备安装阶段,预计 2023 年第四季度完成产线建设、开始试产。

此外,FCBGA 项目将引入 5 名战略投资者,目前交割先决条件均已成就,公司将继续推进交割并有序推进 FCBGA 封装基板项目建设进程。

### 四、北京收购项目的进展介绍

2023 年 6 月 20 日,揖斐电电子(北京)有限公司完成了工商变更登记手续,更名为北京兴斐电子有限公司(以下简称“兴斐电子”),成为广州兴森投资有限公司全资子公司,本次收购对价为 8.27 亿元人民币。

截至目前,本次收购已完成,兴斐电子将在 2023 年 7 月纳入合并范围。目前已完成对兴斐电子核心团队的股权激励,资产、业务等整合工作全面展开,业务拓展工作稳步推进,除三星和国内主流手机品牌客户之外,高端光模块的认证工作也已启动。

### 五、公司未来发展方向

目前,面临经济低迷、需求不振和竞争加剧的挑战,以及收入和利润

	下滑的短期经营压力,但着眼未来,公司仍坚定加码数字化转型和高端封装基板战略,尤其在行业低迷时期更应专注于布局未来和修炼内功。公司的数字化转型稳步推进;FCBGA 封装基板项目持续加注,客户认证、良率提升及产线建设稳步推进;北京揖斐电项目完成收购,基于 Msap 工艺的技术布局业已完成,只待下游需求复苏。
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 22 日